证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-056

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议

● 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易为日常关联交易，属于正常生产经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因上述交易而对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

（1）董事会的审议和表决情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“伟测科技”）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈凯、祁耀亮回避表决。

（2）独立董事的事前认可意见

独立董事在董事会审议该议案前审阅了议案内容，并发表事前认可意见：公司前次日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

（3）独立董事的独立意见

经审议，独立董事认为：公司前次日常关联交易执行遵循自愿、有偿和公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。公司 2024 年度日常关联交易预计的履行程序完备，对公司及子公司的生产经营有积极的影响，属于公司正常经营行为，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。公司董事会在审议此项议案时，关联董事已按规定回避表决，会议的召开、审议和表决程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。综上，独立董事一致同意 2024 年度日常关联交易预计事项。

（4）监事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届监事会第三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

经审议，监事会认为：本次日常关联交易的事项，主要为涉及公司日常经营活动的关联交易业务，符合公司实际经营需要。上述关联交易遵循公允合理的原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易决策程序合法、合规，公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，上述议案的审议程序及表决结果合法有效。

（5）本议案无需提交股东大会审议。

2、本次日常关联交易预计金额和类别

本次拟对公司 2024 年度（以下简称“本次交易期间”）与关联方的日常交易情况进行预计。本次交易期间日常关联交易预计和执行情况详见下表：

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额(万元)	占同类业务比例	本年年初至 2023 年 10 月 15 日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	占同类业务比例	本次预计金额与 2023 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	强一半导体(苏州)股份有限公司	240.00	4.10%	78.97	1.35%	不适用
	上海季丰电子股份有限公司	20.00	0.34%	0.00	0.00%	不适用
	圆周率半导体(南通)有限公司	20.00	0.34%	0.00	0.00%	不适用
	小计	280.00	4.78%	78.97	1.35%	—
向关联人提供劳务	普冉半导体(上海)股份有限公司	2,160.00	2.95%	2,048.29	2.79%	不适用
	中微半导体(深圳)股份有限公司	75.00	0.10%	90.78	0.12%	不适用
	核芯互联科技(青岛)有限公司	90.00	0.12%	82.44	0.11%	不适用
	小计	2,325.00	3.17%	2,222.51	3.02%	—
合计		2,605.00	—	2,300.48	—	—

注 1：为避免构成 2024 年度盈利预测，本次关联交易的预计金额占同类业务比例 = 本次预计金额 /2022 年度经审计同类业务营业收入或采购金额；

注 2：本年年初至 2023 年 10 月 15 日与关联人累计已发生的交易金额未经审计；

注 3：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

3、前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第一届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2023 年度与关联方的日常交易情况进行了预计，相关日常关联交易预计和执行情况详见下表：

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额(万元)	本年年初至 2023 年 10 月 15 日实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	强一半导体(苏州)股份有限公司	300.00	78.97	不适用
	上海季丰电子股份有限公司	100.00	0.00	不适用
	圆周率半导体(南通)有限公司	–	0.00	不适用
	小计	400.00	78.97	—
向关联人提供劳务	普冉半导体(上海)股份有限公司	3,000.00	2,048.29	基于实际业务发展情况所致
	中微半导体(深圳)股份有限公司	200.00	90.78	不适用
	核芯互联科技(青岛)有限公司	–	82.44	不适用
	小计	3,200.00	2,221.51	—
合计		3,600.00	2,300.48	—

注 1：公司董事祁耀亮于 2022 年 7 月开始担任圆周率半导体（南通）有限公司董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，圆周率半导体（南通）有限公司因此成为公司的关联方，本年年初至 2023 年 10 月 15 日，公司与圆周率半导体（南通）有限公司未发生关联交易。

注 2：公司董事陈凯于 2023 年 4 月开始担任核芯互联科技（青岛）有限公司董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，核芯互联科技（青岛）有限公司因此成为公司的关联方，相关关联交易金额未达董事会审议标准；

注 3：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

二、关联人基本情况和关联关系

1、普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“普冉股份”）

（1）关联人的基本情况

公司名称	普冉半导体(上海)股份有限公司	
公司类型	股份有限公司(上市、外商投资企业投资)	
法定代表人	王楠	
注册资本	75,515,285.00 元人民币	
成立日期	2016 年 1 月 4 日	
住所及主要办公地点	中国(上海)自由贸易试验区申江路 5005 弄 1 号 9 层整层(实际楼层 8 楼)	
主营业务	半导体、集成电路及相关产品的开发、设计、销售，网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，技术转让，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	
实际控制人	王楠	
最近一个会计年度主要财务数据(万元)(经审计)	项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
	总资产	240,654.49
	净资产	198,412.46
	营业收入	92,482.83
	净利润	8,314.63

注：普冉股份最近一个会计年度经审计的主要财务数据来源于普冉股份于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年年度报告》。

（2）与公司的关联关系：公司董事陈凯担任普冉股份董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 15.1 条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

（3）履约能力分析：普冉股份为依法存续且经营正常的科创板上市公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

2、中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“中微半导”）

（1）关联人的基本情况

公司名称	中微半导体(深圳)股份有限公司	
公司类型	其他股份有限公司(上市)	
法定代表人	周彦	
注册资本	400,365,000.00 元人民币	
成立日期	2001 年 6 月 22 日	
住所及主要办公地点	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91 号景兴海上大厦 2101	
主营业务	集成电路、计算机软件产品、电子及电子相关产品的设计、技术开发与销售；经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)	
实际控制人	YANG YONG	
最近一个会计年度主要财务数据(万元)(经审计)	项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
	总资产	336,925.27
	净资产	318,800.14
	营业收入	63,679.37
	净利润	5,917.73

注：中微半导最近一个会计年度经审计的主要财务数据来源于中微半导于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中微半导（深圳）股份有限公司 2022 年年度报告》。

（2）与公司的关联关系：公司董事陈凯担任中微半导董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 15.1 条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

（3）履约能力分析：中微半导为依法存续且经营正常的科创板上市公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

3、核芯互联科技（青岛）有限公司（以下简称“核芯互联”）

（1）关联人的基本情况

公司名称	核芯互联科技(青岛)有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	胡康桥
注册资本	3,054.780391 万人民币
成立日期	2018 年 12 月 7 日
住所及主要办公地点	山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号 D2 楼 2701
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；软件开发；集成电路销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东	胡康桥
最近一个会计年度主要财务数据	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。

（2）与公司的关联关系：公司董事陈凯担任核芯互联董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 15.1 条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

（3）履约能力分析：核芯互联为依法存续且经营正常的公司，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

4、强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“强一股份”）

（1）关联人的基本情况

公司名称	强一半导体(苏州)股份有限公司
公司类型	股份有限公司(港澳合投资、未上市)
法定代表人	周明
注册资本	9,716.9418 万元人民币
成立日期	2015 年 8 月 28 日
住所及主要办公地点	苏州工业园区东长路 18 号 39 幢 2 楼
主营业务	研发、加工、生产、销售；半导体产品、集成电路测试设备、计算机软件，并提供相关产品的售后服务和技术服务；半导体芯片、连接器、继电器的销售及售后服务；从事上述产品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东	周明
最近一个会计年度主要财务数据	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。

（2）与公司的关联关系：公司董事祁耀亮担任强一股份董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 15.1 条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

（3）履约能力分析：强一股份为依法存续且经营正常的公司，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

5、上海季丰电子股份有限公司（以下简称“季丰电子”）

（1）关联人的基本情况

公司名称	上海季丰电子股份有限公司
公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	郑朝晖
注册资本	11,558.60 万元人民币
成立日期	2008 年 7 月 7 日
住所及主要办公地点	上海市闵行区友东路 258-288 号 2 幢 101 室
主营业务	一般项目：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；软件开发；软件销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；模具制造；模具销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：检验检测服务；发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东	郑朝晖
最近一个会计年度主要财务数据	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。

（2）与公司的关联关系：公司董事祁耀亮担任季丰电子董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 15.1 条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

（3）履约能力分析：季丰电子为依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。

6、圆周率半导体（南通）有限公司（以下简称“圆周率半导体”）

（1）关联人的基本情况

公司名称	圆周率半导体(南通)有限公司
公司类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人	周明
注册资本	3,231.6763 万元人民币
成立日期	2021 年 4 月 27 日
住所及主要办公地点	南通高新区康富路 898 号
主营业务	许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；机械设备研发；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；有色金属合金销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东	周明
最近一个会计年度主要财务数据	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。

（2）与公司的关联关系：公司董事祁耀亮担任圆周率半导体董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 15.1 条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

（3）履约能力分析：圆周率半导体为依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司对 2024 年度预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品或提供劳务。公司与上述关联方所进行的关联交易均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。

2、关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人发生交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格合理确定。公司与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：伟测科技 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益；履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。

保荐机构对伟测科技预计 2024 年度日常关联交易额度的事项无异议。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

● 报备文件

1、第二届董事会第三次会议决议；

2、第二届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

5、方正证券承销保荐有限责任公司关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-057

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 11 月 14 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区东胜路 38 号 D1 栋会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。公司将在 2023 年第二次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2023 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688372	伟测科技	2023/11/3

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于 2023 年 11 月 10 日（上午 10:00～11:30，下午 13:00～16:00）到公司董事会办公室进行股权登记。

（二）登记地点

上海市浦东新区东胜路 38 号 D1 栋

（三）登记方式

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

3、股东可按以上要求以信函或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料应不迟于 2023 年 11 月 10 日 16:00，登记时应注明股东联系人、联系电话及“伟测科技 2023 年第二次临时股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

2、会议联系方式

联系人：王沛

联系电话：021-58958216

联系地址：上海市浦东新区东胜路 38 号 D1 栋

电子邮箱：ir@v-test.com.cn

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

第二届董事会第三次会议决议

附件 1：授权委托书

上海伟测半导体科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会授权委托书

上海伟测半导体科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 14 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》			
2	《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2023 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-054

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“伟测科技”）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），同意公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价格为 61.49 元 / 股，募集资金总额为 134,064.80 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,346.85 万元后，实际募集资金净额为人民币 123,717.95 万元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 21 日审验出具“天健验字〔2022〕6-69 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

1、根据《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入
1	无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	48,828.82	48,828.82
2	集成电路测试研发中心建设项目	7,366.92	7,366.92
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		61,195.74	61,195.74

2、超募资金用于在建项目及新项目的情况

（1）公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 30,000.00 万元分别向全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称“无锡伟测”）增资 15,000.00 万元及向全资子公司南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）增资 15,000.00 万元，分别用于投资建设新项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”及“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2022 年 11 月 28 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

（2）公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 10,000.00 万元向全资子公司南京伟测提供借款，用于继续实施募投项目“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

（2）公司于 2023 年 6 月 30 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 10,000.00 万元向全资子公司无锡伟测提供借款，用于继续实施募投项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2023 年 7 月 18 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

三、本次使用部分超募资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的情况

南京伟测为公司的全资子公司，公司的募集资金投资项目中“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”实施主体为南京伟测。根据该募投项目的实施进度及资金需求，公司本次拟将剩余超募资金 133,474,873.89 元（本金额为截至 2023 年 10 月 20 日存放超募资金的募集资金专户的资金余额）及孳息向南京伟测提供借款用于继续实施该募投项目。上述募集资金将直接汇入南京伟测募集资金专户，南京伟测将根据该募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，以提高募集资金的使用效率。

公司股东大会审议通过本次使用剩余超募资金向南京伟测提供借款用于继续实施募投项目的事项后，公司首次公开发行股票募集资金的超募资金部分将全部确定实施用途，超募资金的具体使用情况如下：

序号	超募资金投资项目名称	超募资金投入金额(元)
1	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	250,000,000.00
2	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	383,474,873.89 注
合计		633,474,873.89

注：该金额不包含本次拟使用的超募资金截至 2023 年 10 月 20 日之后至转出日之间产生的孳息金额。

四、本次借款对象的基本情况

公司名称	南京伟测半导体科技有限公司
统一社会信用代码	91320111MA2798JE32
法定代表人	骈文胜
注册资本	25,000 万人民币
成立日期	2021 年 10 月 21 日
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务(不含出版物出租)；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；软件开发；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	公司持有南京伟测 100%的股权
最近一年主要财务数据（万元）(经审计)	项目 2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
	总资产 77,209.77
	净资产 27,015.49
	营业收入 6,581.74
	净利润 2,048.43

五、本次借款对公司的影响

公司本次向全资子公司南京伟测提供借款系基于推进募集资金投资项目建设的需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次借款后，南京伟测的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

六、本次使用部分超募资金实施募投项目的具体情况

（一）项目概况

项目主要用于扩大公司的集成电路测试服务规模，购置土地、建设厂房并购置相关生产、测试设备，提高公司集成电路测试服务产能、效率和交付能力。项目的实施是公司把握市场机遇、快速提升集成电路测试服务的品质和综合竞争力的重要举措，不仅有助于提升公司测试规模和市场竞争力，满足终端客户需求，而且能够提高规模化成本竞争优势，获取更大的增值空间，符合公司可持续发展的战略需要。

（二）项目基本情况

1、项目名称：伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目

2、项目建设内容：项目拟建设集成电路晶圆测试线和成品测试线

3、项目实施主体：南京伟测半导体科技有限公司

4、项目实施地点：本项目拟选址于江苏省南京市浦口经济开发区，项目的实施主体南京伟测已完成相关的国有建设用地使用权的权属登记手续，并取得南京市规划和自然资源局浦口分局出具的《中华人民共和国不动产权证书》。

5、项目实施周期：本项目建设周期为 60 个月（最终以实际开展情况为准）

6、项目资金金额及来源：本项目的投资额为 9 亿元，公司本次拟使用部分超募资金 133,474,873.89 元及孳息向南京伟测提供借款以实施该项目，本次借款事项经公司股东大会审议通过后，公司合计使用部分超募资金 383,474,873.89 元（该金额未包含本次拟使用的超募资金截至 2023 年 10 月 20 日之后至转出日之间产生的孳息金额）实施该项目。

7、项目的前序相关审议程序：公司于 2021 年 9 月 20 日及 2021 年 10 月 8 日分别召开第一届董事会第九次会议及 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司签署投资协议的议案》，公司拟在江苏省南京市浦口区投资建设集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目，项目总投资额为 9 亿元人民币，项目实施主体为南京伟测。

（三）项目实施的必要性及可行性分析

1、必要性分析

（1）公司顺应国家推动集成电路产业国内自主可控战略发展趋势，进行前瞻性战略布局的需要

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，集成电路产业以其重要的战略地位逐渐成为国际竞争的主战场、全球关注的核心焦点。

面对国际环境继续深度调整，发展环境的诸多变化，我国必须突破传统创新组织和模式，探索关键核心技术攻关，以尽快实现关键产品的自主可控。

因此，我国集成电路技术创新发展已步入新阶段，我国超大规模的市场优势和内需潜力将转变为最大的比较优势，有望通过构建基于国内大规模市场的国内产业链，加速国产替代，为我国集成电路产业带来难得的发展机遇。

集成电路测试则是集成电路制造流程中的重要一环，公司以集成电路测试为核心业务，与晶圆厂和封测厂达成紧密协作，为集成电路设计公司提供了先进的技术服务和商业价值，在我国大力发展自主可控的集成电路产业链背景下，公司新增产能的布局也必将享受行业发展的红利。

（2）顺应集成电路测试专业化分工发展趋势，提高市场地位的需要

伴随集成电路制程演进和工艺日趋复杂化，制造过程中的参数控制和缺陷检测等要求越来越高，集成电路测试专业化的需求不断提升。与此同时，芯片设计趋向于多样化和定制化，对应的测试方案也多样化，对测试的人才和经验要求提升，将测试流程进行外包有利于降低中小企业的负担并提高效率。集成电路产业高度细化分工背景下，集成电路测试走向专业化是发展趋势。

公司作为的专业集成电路测试企业，可面向集成电路的功能、性能和可靠性提供丰富多样的测试技术并且具备定制化测试方案的服务能力，设备配置更有针对性和兼容性。公司凭借丰富、灵活的测试解决方案，通过扩建产能，进一步发挥公司专业化优势，能够面向集成电路全产业链的广泛需求提供测试服务，市场地位有望持续提升。

（3）获取先发优势，提升公司核心竞争力的需要

目前国内专业测试产能严重不足，大部分测试厂商定位中低端市场，不具备开发测试方案和程序的能力。因此，率先实现产能扩张、建立技术优势的厂商先发优势明显。本次超募资金的投入将有助于公司产能的继续扩张，将有效保证公司产能供应的稳定性，同时，本次项目的实施产生的规模效应有利于公司进一步提升测试效率，降低测试成本，以专业测试能力获得更多客户的青睐，有利于进一步帮助公司通过规模和技术壁垒加大与竞争者的差距，是公司抢占市场先机的重要举措，有助于提高公司整体盈利水平，提升公司的核心竞争力。

2、可行性分析

（1）国家政策大力支持集成电路行业发展

受益于国家政策对集成电路产业的大力支持，国内整个集成电路产业链依旧会保持高速增长的态势。同时从行业战略的角度来看，考虑到芯片